

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2024-084

## 深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	德明利	股票代码	001309
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于海燕	李格格	
办公地址	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2401	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2401	
电话	0755-23579117	0755-23579117	
电子信箱	dml.bod@twsc.com.cn	dml.bod@twsc.com.cn	

### 2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,176,088,235.83	590,531,539.25	268.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	387,647,150.47	-79,416,483.65	588.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	369,975,680.17	-84,723,113.19	536.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-659,850,872.25	-409,692,252.72	-61.06%
基本每股收益（元/股）	2.63	-0.54	587.04%
稀释每股收益（元/股）	2.63	-0.54	587.04%
加权平均净资产收益率	29.40%	-7.55%	36.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,862,893,933.39	3,288,196,110.77	47.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,517,324,981.44	1,122,034,573.15	35.23%

## 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,761	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李虎	境内自然人	39.57%	58,401,775.00	58,401,775.00	质押	9,360,000.00
魏宏章	境内自然人	6.17%	9,099,335.00	0	质押	2,990,000.00
重庆金程源企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.49%	8,107,043.00	0	不适用	0
徐岱群	境内自然人	4.44%	6,556,059.00	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	1.13%	1,661,062.00	0	不适用	0
LEADINGUI CO., LTD.	境外法人	1.06%	1,561,442.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	1,489,305.00	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司—德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	其他	0.94%	1,390,000.00	0	不适用	0
交通银行股份有限公司—南方成长先锋混合型证券投资基金	其他	0.93%	1,365,780.00	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资	其他	0.70%	1,026,774.00	0	不适用	0

基金					
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 1、与朗科科技的日常关联交易

自公司董事会于 2023 年 7 月 13 日聘任杜铁军先生为公司总经理之日起，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”）及其控制的相关子公司新增为公司关联法人。杜铁军先生于 2023 年 4 月起辞去朗科科技及其相关子公司所有职务，其辞职后 12 个月内，即自 2023 年 7 月起至 2024 年 4 月止，公司与朗科科技及其控制的相关子公司的交易将构成关联交易。在本报告期内，公司与朗科科技实际关联交易金额为 2,837.59 万元，具体为：采购商品金额 0.00 万元，销售商品金额 2,837.59 万元。

#### 2、向宏沛函出售公司触控资产

公司 2023 年 10 月 10 日召开第二届董事会第八次会议审议通过，公司与株式会社 LeadingUI Co., Ltd. 以及自然人张美莉在深圳市签订了《投资合作框架协议》。协议内容主要包括拟成立合资公司深圳市宏沛函信息技术有限公司（曾用名：珠海市宏沛函信息技术有限公司。以下简称“宏沛函”）及后续宏沛函将对本公司触控业务涉及的整体资产进行收购。经公司 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司与宏沛函签订了触控业务资产组转让的相关协议，经各方协商，标的资产的转让价格为 2,417.08 万元。截至 2024 年 6

月 30 日，公司已向宏沛函出资人民币 400.00 万元，已办妥转让的标的资产金额 2,346.01 万元，尚有 3 项涉及质押担保的 3 项发明专利，待该质押担保于 2024 年 8 月 18 日到期后再办理转让过户手续。

### 3、向金融机构申请授信额度及接受关联方担保

公司于 2024 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议、2024 年 3 月 19 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过 30 亿元人民币的综合授信/借款额度，并接受实际控制人李虎、田华为公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保额度不超过 40 亿元。

由于公司日常经营所需，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，公司拟增加 2024 年度向银行等金融机构申请不超过 20 亿元人民币的综合授信/借款额度，并接受实际控制人李虎、田华为公司本次增加向金融机构申请综合授信/借款提供无偿连带责任保证担保额度不超过 20 亿元。该议案尚需经公司股东大会审议通过后生效。

本次增加综合授信/借款额度和接受关联方担保额度后，公司 2024 年向金融机构申请综合授信/借款总额度合计不超过人民币 50 亿元，接受关联方担保额度合计不超过人民币 60 亿元，有效期均为该事项获公司股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日的前一日止。

### 4、为子公司源德提供担保

公司于 2023 年 5 月 8 日召开第一届董事会第三十一次会议、第一届董监事会第二十七次会议，于 2023 年 6 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。根据经营发展需要，公司全资子公司源德（香港）有限公司（以下简称“源德”）向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信总额度不超过 1 亿元，公司为其提供不可撤销的连带责任保证。

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届董监事会第十次会议，于 2023 年 6 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司源德拟与电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司（以下简称“电子交易中心”）签订《货物销售合同》，合同约定源德将按照市场价格向电子交易中心采购 FLASH 晶圆、半成品等物料，具体采购数量和单价以电子交易中心依据源德向电子交易中心下达采购要约而提供的“销售订单”为准。公司将为源德与电子交易中心基于上述《货物销售合同》对电子交易中心形成的全部债务，在不超过人民币 2.1 亿元额度内提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下相关债务履行期限届满之日起三年。

公司于 2024 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》，为了满足公司 2024 年度日常经营及业务发展所需，公司将为全资子公司源德提供总额不超过人民币 15 亿元（或等值外币）的担保额度，本担保额度预计的有效期为自本次担保额度预计事项获公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

公司仅存在对源德提供担保的情形。截至 2024 年 6 月 30 日，公司对源德提供的已签订担保合同的担保余额为人民币 1.96 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.47%。目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况。

#### 5、智能制造（福田）存储产品产业基地项目

公司于 2022 年 8 月 4 日召开第一届董事会第二十二次会议、于 2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟租赁新物业投资建设智能制造（福田）存储产品产业基地项目的议案》，同意公司租赁深圳市福田区八卦岭八卦四路中厨 6 号综合厂房第 1-7 层用于建设智能制造（福田）存储产品产业基地项目，具体内容详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露日，公司福田分公司已由原地址深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 387 号 1 栋 3 层、4 层、5 层整体搬迁至新地址深圳市福田区园岭街道上林社区八卦四路 14 号中厨 6 号综合厂房 101 第 1-7 层，目前所有设备均已安装完成，投入量产。

#### 6、公司 2023 年向特定对象发行股票事项

公司于 2023 年 6 月 29 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、于 2023 年 7 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，公司于 2024 年 1 月 15 日对以上文件进行了修订，并披露了《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件；2024 年 6 月 27 日，公司对相关文件再次进行了修订，并披露了《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关文件。2024 年 8 月 6 日，公司对相关文件再次进行了修订，并披露了《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》等相关文件。目前该事项正在深圳证券交易所审核中心审理过程中。

#### 7、募集资金结项

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 522.90 万元（全部为累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金划转日专户余额为准），用于永久补充流动资金，同时注销相关的募集资金专户。

#### 8、设立北京分公司

公司于 2024 年 3 月 15 日成立深圳市德明利技术股份有限公司北京分公司，北京分公司统一社会信用代码为 91110108MADKNUL72，地址为北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 5 层 101，负责人陶立平，一般经营范围项目为：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路芯片设计及服务；货物进出口；技术进出口；数据处理和存储支持服务；集成电路销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 9、设立杭州分公司

公司于 2024 年 7 月 9 日成立深圳市德明利技术股份有限公司杭州分公司，杭州分公司统一社会信用代码为 91330108MADP53FT1B，地址为浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨文路 868 号闻涛新生大厦 1 幢 10 层 1001 室，负责人陶立平，一般经营范围项目为：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路芯片设计及服务；货物进出口；技术进出口；数据处理和存储支持服务；集成电路销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### 10、在香港设立二级子公司

公司全资子公司深圳市治洋存储有限公司于 2024 年 6 月 27 日在香港设立子公司治洋存储（香港）有限公司，英文名 OASIS.C (HONGKONG) CO., LIMITED，注册资本为 100 万港币，董事为李虎，主要从事电脑相关周边设备，电子器件制造，加工，进出口及批发业务。

#### 11、2023 年限制性股票激励计划回购注销与预留部分授予

公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销 8 名离职人员已授予登记尚未解除限售的 2023 年限制性股票共 30,800 股。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分的授予数量、授予价格的议案》并发布相关公告（公告编号：2024-034），因公司实施 2023 年度权益分派（每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股），2023 年限制性股票激励计划中预留部分股份数量由 25.452 万股调整为 33.0876 万股，授予价格由原 24.66 元/股调整为 18.87 元/股；于 2024 年 5 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》并发布相关公告（公告编号：2024-040），以 2024 年 5 月 9 日为授予日，向符合授予条件的 14 名激励对象授予预留部分限制性股票 33.0876 万股，授予价格为 18.87 元/股；于 2024 年 5 月 29 日发布了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2024-046），本次授予限制性股票的上市日期为 2024 年 6 月 4 日。

#### 12、2020 股票期权激励计划注销、调整和第二次行权

公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权股票期权的议案》并发布相关公告（公告编号：2024-013），注销 2 名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权 1.295 万份；于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的期权数量及行权价格的议案》并发布相关公告（公告编号：2024-036），因公司实施 2023 年度权益分派（每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股），2020 年股票期权激励计划第二个行权期已缴款待行权登记的股票期权数由 5.635 万份调整为 7.3255 万份，尚处等待期的股票期权数量由 3.381 万份调整为 4.3953 万份；行权价格由 7.01 元/份调整为 5.29 元/份；于 2024 年 6 月 18 日发布了《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股票上市的公告》（公告编号：2024-053），本次实际行权的激励对象共 6 人，实际行权的股票期权数量为 73,255 份，行权价格为 5.29 元/份，行权股票上市日期为 2024 年 6 月 20 日，由于本次行权股票上市后的限售期为 36 个月，故本次行权股票实际可流通日为 2027 年 6 月 20 日。

#### 13、2024 限制性股票激励计划

公司于 2024 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案并发布相关公告（公告编号：2024-063、2024-076），拟向激励对象授予限制性股票数量为 147.00 万股（其中预留 29.40 万股），首次授予的激励对象总人数为 101 人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及公司董事会认定需要激励的其他员工。

#### 14、2023 年权益分派

公司于 2024 年 3 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，于发布了《2023 年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2024-030），以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 113,247,800 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本次权益分派股权登记日为 2024 年 4 月 25 日，除权除息日为 2024 年 4 月 26 日。2024 年 4 月 26 日，本次权益分派已实施完毕。

#### 15、公司章程与注册资本的变更

公司于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议、于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案，公司于 2024 年 7 月 2 日完成《公司章程》的修改和公司注册资本的工商变更登记手续，公司注册资本变更为 147,512,976 元。

公司完成 2020 年股票期权激励计划第二期行权登记，导致公司注册资本增加 73,255 元，公司注册资本变更为 147,586,231 元，此次变更尚需修改《公司章程》及办理工商变更登记。